

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

上海富瀚微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	郭星岩 北京禹田资本管理有限公司 周勃宇 财通证券 张宜欣 高腾国际资产管理有限公司 张琮 广东正圆私募基金管理有限公司 吴耀聪 广州市圆石投资管理有限公司 闫慧辰 红杉中国投资管理有限公司 谭行悦 华宝基金管理有限公司 高远 华创证券 王臣复 华金证券 林文富 华泰证券 彭双宇 华夏人寿保险股份有限公司 刘春胜 蓝海启程（北京）投资管理有限公司 魏晓雪 纽伯格伯曼欧洲有限公司 苟思雨 平安理财有限责任公司 高翔 浦银安盛基金管理有限公司 柯伟 上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙） 姜宇帆 上海明河投资管理有限公司 胡建芳 上海磐厚投资管理有限公司 卫泓 上海青鼎资产管理有限公司 高峰 上海森锦投资管理有限公司 王怡凡 上海元昊投资管理有限公司 刘志敏 上海长见投资管理有限公司 梁悦芹 闻天私募证券投资基金管理（广州）有限公司 王嘉源 西南证券 万毅 信达资本管理有限公司 韦琦 玄卜投资（上海）有限公司 夏一 玄卜投资（上海）有限公司 郝彪 誉辉资本管理（北京）有限责任公司 赵万隆 长盛基金管理有限公司 熊英 中荷人寿保险有限公司 杨然诺 中金公司 郭立江 中信证券	

时间	2026 年 4 月 3 日
地点	公司会议室（电话会议）
上市公司 接待人员 姓名	董事长兼总经理 杨小奇先生 副总经理兼董事会秘书 万建军先生 投资者关系总监 吴斯文先生
投资者关 系活动主 要内容介 绍	<p>Q&A 环节</p> <p>Q1：请分享公司如何看待端侧和边缘侧芯片市场的未来发展，以及公司相应的战略规划。</p> <p>A：我们公司多年来一直专注于视觉处理领域，持续大力投入端侧和边缘侧的 AI 芯片。从战略层面看，随着大模型的快速发展和需求增长，我们观察 2026 年端侧 AI 已经进入了“token 经济”阶段。云端 AI 已经形成明确的商业模式，用户对模型使用的 token 消耗费用较高，端侧和边缘侧通过本地处理能大幅降低用户的成本。我们已有带算力的芯片支持端侧大模型应用，客户已有实际应用案例。今年开始，我们会针对端-云结合的大模型 token 应用推出更具针对性的 SoC 芯片，以满足家庭和企业客户需求。总体来看，公司具备强大的芯片设计和大模型技术储备，加上算法和系统能力，已经为构建基于富瀚芯片生态的大模型应用体系做了几年准备。目前我们已经协助下游客户部署私有云端大模型产品，未来将在家庭智能中心领域发力，推动以富瀚芯片为核心的大模型应用生态。</p> <p>Q2：请问公司如何看待当前智能视频市场的景气度及未来展望？</p> <p>A：智能视频市场自 2025 年一、二季度已经逐步回暖，目前订单量依然很大，处于供货紧张的状态。上游存储颗粒存在结构性缺货，这种缺口也向下游传导，导致下游客户抢货情形普遍。目前，此类芯片市场供货紧张的局面短期内难以缓解。整体来看，智能视频市场依旧处于景气上行阶段。</p> <p>Q3：公司产品中 IPC 芯片占比大概多少？近期内存价格涨幅及对产品毛利和客户接受度的影响如何？</p> <p>A：公司产品主要分为三大类：ISP、IPC 和边缘侧 XVR 芯片。IPC 芯片主要采用合封内存，占公司芯片总出货量的近 60%。内存在芯片成本中占比涨幅较大，涨价前约占 40%以下，涨价后提升至 60%甚至以上。我们将涨价传导给下游客户，客户普遍理解并</p>

接受，客户也能继续向下游传导。内存涨价对整体毛利率有一定压力，但从去年下半年至今年初来看，毛利率总体保持稳定。同时公司也采用 PSRAM 等替代方案缓解 DDR 缺货带来的成本压力，期望保持毛利率相对平稳。

Q4：市场上 DDR 价格出现回落，公司如何判断未来 DDR 价格走势和涨价持续性？

A：虽然最近市场传出 DDR4/5 价格下调的消息，但目前从供应商反馈信息看，针对公司产品使用的以 DDR2/3 为主的 KGD 内存颗粒价格仍无回落迹象，涨价趋势尚未出现拐点。整体来看，DDR2/3 价格仍保持高位，短期内没有明显转降迹象。

Q5：请分享晶圆代工及封测价格趋势判断，及中东形势是否影响价格？

A：封测环节价格出现小幅上涨，主要受需求上涨和原材料上涨影响，但涨幅较 KGD 涨价小得多。晶圆厂价格尚稳定。至于中东局势对价格的影响，暂时未见明显涨价风险，公司会继续与业务部门紧密沟通，保持对价格信息的持续跟踪。

Q6：请介绍 2026-2027 年公司新产品的规划及放量节奏，特别是 AI-ISP 芯片、边缘侧芯片 AIoT 芯片及车载芯片。

A：2026 年公司将有较多新品发布，主要体现在新方向和新技术两方面。新方向上，首个产品是面向安卓设备的多核主控芯片，这是公司进军安卓系统巨大市场的关键一步；其次是面向运动穿戴市场的低功耗、防抖性能优异的 IPC 芯片，适用于运动相机和 AI 眼镜等高要求消费电子产品；第三是面向笔记本电脑市场的摄像芯片。技术方面，则是 AI-ISP 技术升级至第二代，并首次应用于车载摄像芯片，将有效解决新能源车哨兵模式高能耗问题。这些新品将逐步放量，推动公司技术和市场的双向发展。

Q7：请介绍一下公司在机器人及端侧技术领域的布局和规划情况。

A：现阶段，公司在机器人相关的摄像芯片领域已有一定布局。首先，我们已经实现了工业视觉芯片的量产，主要供给工业机器人客户。其次，我们通过方案公司向头部人形机器人客户提供芯片。此外，公司也在积极拓展新的领域，比如陪伴机器人客户，满足他们对摄像芯片的需求。关于主控芯片方面，目前我们正在储备多项核心技术，等待合适的切入时机。我们还参股了算法项目，专注于空间智能算法的储备，以提升机器人理解物理世界的能力。

Q8：车载业务进展如何？对未来收入和市场竞争，公司有何判断及策

	<p>略？</p> <p>A：车载业务近几年实现了稳定增长，车载前装业务周期较长，需要持续的研发和市场铺垫。公司布局的 MIPI-APHY 传输芯片已成功批量上车，目前在某民营车厂创新车型配备，收到良好反馈。随着智能驾驶需求增长，公司正加紧开发新芯片，融入 AI-ISP 技术，通过高效节能方案，优化车辆的哨兵模式。尽管行业竞争激烈，但因技术和时间门槛高，能有效参与的玩家不多，也保障了较好的毛利率。去年公司推出的 800 万像素电子后视镜新产品，已成为某车厂旗舰车型的重要亮点，同时也有车载产品成功进入部分德系豪华品牌供应链，体现了中国供应链技术力量的提升。综合来看，车载业务未来增长潜力大，具备较为乐观的前景。</p> <p>Q9：请介绍 AI 眼镜产品的量产进展及对 AI 眼镜市场爆发和中长期业务规模的想法。</p> <p>A：根据 IDC 数据，2025 年中国 AI 眼镜出货量约 250 万台，其中包含不少无摄像头的音频眼镜。这一规模对应的芯片出货量相比公司其他百万级甚至上亿级出货量的产品，市场容量仍较小。公司客户已实现眼镜产品量产，主要面向 B 端市场，如博物馆导览等应用，但整体量级不大。公司的方案经过实际验证，为市场打开了突破口。对于大规模爆发，公司认为关键不在芯片本身，而是要靠 AI 眼镜本身产品创新和杀手级应用的诞生，让用户建立日常依赖，使眼镜从类玩具转变为日常工具。只有这样，眼镜市场才会迎来真正的爆发和业务规模提升。</p> <p>Q10：未来 5 到 10 年，公司对业务结构和收入规模有何预期？</p> <p>A：过去几年，公司在智能视频领域持续迭代产品服务大客户，未来仍会稳步推进。同时，公司积极开拓外延领域，特别是在相机领域已经做了多年的准备。今年计划推出运动相机产品，突破传统边界。运动相机作为消费类高端应用领域，市场潜力大，有望通过努力取得良好业绩。下游客户正在配合开发相关产品。针对端侧和边缘侧大模型应用，公司已推出解决方案和相关芯片，应用于家庭智能中心等智能设备。同时，今年将发布自有安卓类大芯片，进一步丰富智能视频和智能物联网的产品系列。智能车行业务处于高速增长通道中。综上，未来 3 至 5 年内，公司希望营收达到 50 亿元规模，涵盖智能视频、智能物联网、边缘计算大模型应用、家庭智能中心及快速增长的车载市场。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 4 月 3 日